

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	天风证券、摩根士丹利基金、中信保诚基金、宁银理财、天风资管、国新证券、嘉实基金、永赢基金、东吴基金、LCRICH CAPITAL MANAGEMENT、广东正圆投资、昆仑信托、上海高澈投资、承珞投资、循远资管、农银人寿保险、湖南源乘私募、上海兆天投资、上海混沌投资、玄卜投资、上海赢动私募、天津远策投资、东兴基金、葆金峰投资、长城财富保险、上海道合私募、中银基金、长城财富保险、常春藤上海资管、咸和资管、信泰人寿保险、明世伙伴私募、国寿安保基金、杭州拾年投资、上海混沌投资、金鹰基金、红华资本、方正证券、新疆前海联合基金、上海季胜投资、西藏青骊资管、浙江米仓资管、东方睿石投资、颐和久富投资、金元顺安基金、国元证券、路博迈基金、英大保险、Willing Capital Management Limited、长安基金、中国国际金融
时间	2025年5月26日
地点	电话会
上市公司 接待人员姓名	总经理：向文胜 常务副总经理、董事会秘书：陈小华

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问题一：请问公司先进封装领域产品布局及进展情况？</p> <p>答：公司先进封装领域产品涉及光刻胶及配套试剂、电镀液及配套试剂。首先是先进封装负性光刻胶，产品已覆盖多家主流封装厂，市场渗透率持续提升。后续公司将进一步丰富产品型号，以实现全品类覆盖，不断巩固和扩大在该领域的市场份额，目标成为国内先进封装光刻胶的主力供应商。</p> <p>另外先进封装电镀方面，为了配合电镀锡银的产业化和国产化，针对 Ultra Low-α Tin（超低 α 锡）等关键材料的半导体应用等方面，公司与国内供应商展开深度的战略合作，目前超低 α 锡阳极产品在客户端验证中。先进封装电镀铜基液在华天科技、通富微电稳定供应，电镀锡银添加剂在长电科技小批量量产。</p> <p>问题二：公司 PSPI 的产品布局、市场格局及市场规模？</p> <p>答：目前，国内 PSPI 产品高度依赖从美国 HDM 公司、日本东丽公司等国外厂商进口。根据中国电子材料行业协会的数据，2023 年中国集成电路用 PSPI 光刻胶市场规模总计 11.93 亿元，预计到 2025 年将增长至 13.28 亿元。</p> <p>公司布局了先进封装 PSPI 和晶圆领域 PSPI 光刻胶，公司自主研发的正性 PSPI 光刻胶成功获得主流晶圆厂首个国产化订单，打破了美日企业在该领域的长期技术垄断，成为国内首家实现该材料进口替代的企业。自 2024 年第三季度开始逐步量产，预计 2025 年将逐步实现规模化出货。同时，公司在 PSPI 光刻胶方面同步布局了负性 PSPI 和高感度化学放大型 PSPI，2025 年计划继续推进 PSPI 产品在先进封装和晶圆厂商的产品认证工作。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025 年 5 月 28 日</p>